

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 19 年 4 月 26 日 (2007.4.26)

【公開番号】特開 2006-2228 (P2006-2228A)
 【公開日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-001
 【出願番号】特願 2004-181479 (P2004-181479)
 【国際特許分類】

B 2 2 F 1/00 (2006.01)
B 2 2 F 9/24 (2006.01)
H 0 1 B 1/22 (2006.01)
H 0 1 B 5/00 (2006.01)
H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

B 2 2 F 1/00 K
 B 2 2 F 1/00 A
 B 2 2 F 9/24 E
 H 0 1 B 1/22 A
 H 0 1 B 5/00 F
 H 0 1 B 13/00 5 0 1 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 3 月 12 日 (2007.3.12)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 5】

銀の融点は 9 6 0 であり、その融点以下の可能な限り高温で焼成すれば、銀の焼結体の抵抗値が下がるが、焼成温度に適した銀粉を使用しなければ、様々な不具合が生じる。例えば、セラミック基板上において高温で焼成する場合には、銀の焼結体とセラミック基板との収縮差によってクラックやデラミネーション（積層剥離）などの不具合が生じることがあり、このような不具合を解消するために、高結晶の銀粉が提案されている（例えば、特許文献 1、特許文献 2 参照）。